

熱ダメージレスの焼結材

低温焼結性銅粉

CH-0200L1

Heat damageless
sintering material

Low temperature
sinterable Cu
powder

用途

ダイボンディング材料、配線材料、電極材料

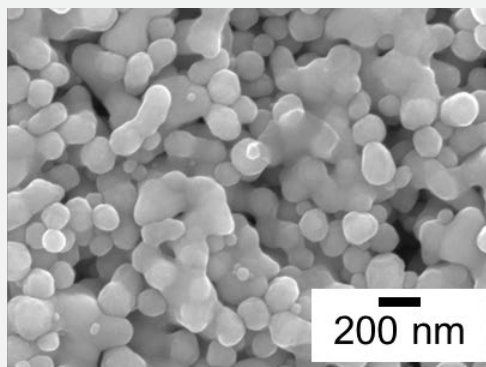
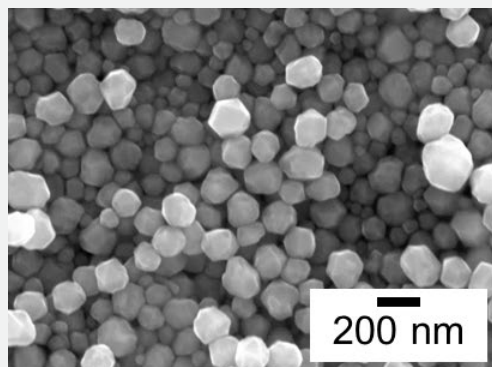
Die-bonding, Wiring, Electrode.

概要・特徴

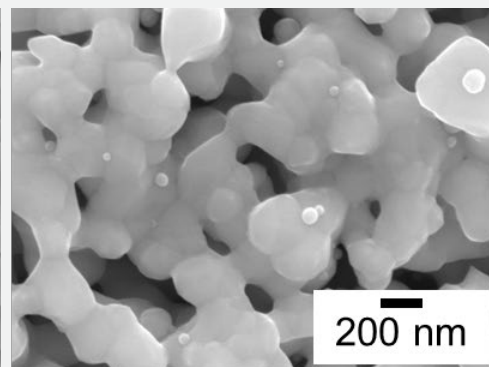
- ・ 粒子径150nmかつ均一な粒度分布の銅粉
Uniform size distribution and particle diameter of 150 nm.
- ・ 190℃の低温かつ短時間処理により焼結可能
Sintering at 190 degrees C in a short time.
- ・ 半導体接合や微細配線などの焼結フィラーとして活用を期待
Used as a sintering material for the die-bonding and fine wiring process.



Fig. Copper powder



$N_2 \times 190^\circ C \times 3min$



$N_2 \times 260^\circ C \times 3min$



三井金属

お問い合わせ
三井金属鉱業(株) 機能性粉体事業部

<https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/kinousei-funtai/>